

上海硅产业集团股份有限公司

关于全资子公司向股东申请借款并由公司为其提供担保

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 为满足集成电路用300mm硅片产能建设的资金需求，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海新昇半导体科技有限公司（以下简称“上海新昇”）拟向公司股东上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）申请借款人民币10亿元，并由公司为本次借款提供担保。
- 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。
- 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	上海新昇半导体科技有限公司
	本次担保金额	100,000 万元
	实际为其提供的担保余额	192,103 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	902,103
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	73.35
特别风险提示（如有请勾选）	☐ 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% ☒ 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对合并报表外单位担保金额达到或超过

	最近一期经审计净资产 30%的情况下 ☐ 对资产负债率超过 70%的单位提供担保
--	--

一、本次借款并由公司为其提供担保暨关联交易事项

（一）本次借款暨关联交易事项

为满足面向国家半导体行业的重大战略需求，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年启动实施“集成电路用 300mm 硅片产能升级项目”，在上海、太原两地建设新增 60 万片/月的 300mm 半导体硅片产能。具体内容详见公司 2024 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于投资建设集成电路用 300mm 硅片产能升级项目的公告》。为满足该项目建设的资金需求，全资子公司上海新昇拟向公司股东国盛集团申请借款人民币 10 亿元。

国盛集团持有公司 546,000,000 股，占公司总股本 19.87%，为公司关联方，因此本次借款事项构成关联交易。

（二）担保事项

公司将为上述借款合同项下上海新昇的义务、责任承担连带保证责任。

（三）审批程序

公司于 2025 年 8 月 12 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于全资子公司向股东申请借款并由公司为其提供担保暨关联交易的议案》，关联董事姜海涛、徐怡婷回避了相关事项的表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。根据《上海证券交易所科创板上市规则》《公司章程》等相关规定，本次全资子公司向股东申请借款并由公司为其提供担保暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人的基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	上海新昇半导体科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）

主要股东及持股比例	上海硅产业集团股份有限公司，100%		
法定代表人	李炜		
统一社会信用代码	91310115301484416G		
成立时间	2014 年 6 月 4 日		
注册地	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云水路 1000 号 1-4 幢、6-19 幢		
注册资本	238,000 万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目：高品质半导体硅片、硅基半导体材料、半导体设备和零部件的研发、生产和销售，半导体材料与器件相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物进出口，技术进出口，企业管理咨询，非居住房地产租赁、机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（合并口径，经审计）	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度（合并口径，经审计）
	资产总额	1,719,424.31	1,442,438.14
	负债总额	844,577.00	689,749.83
	资产净额	874,847.31	752,688.31
	营业收入	211,943.72	139,419.18
	净利润	-42,841.00	13,032.30

三、担保协议的主要内容

经各方协商，公司拟就本次借款向国盛集团出具《担保函》，主要内容包括：

- 1、同意为主合同项下上海新昇的义务、责任承担连带保证责任。
- 2、保证范围为主合同项下主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权费用。
- 3、保证期限为主债务履行期届满之日起六个月。

四、关联人的基本情况

上海国盛（集团）有限公司持有公司 546,000,000 股，占公司总股本 19.87%，为公司关联方。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司未与国盛集团发生关联交易。

上海国盛（集团）有限公司成立于 2007 年 9 月 26 日，法定代表人叶劲松，注册资本 2,006,600 万元，注册地址位于上海市长宁区幸福路 137 号 3 幢 1 楼。其经营范围为开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海市国有资产监督管理委员会持有其 100% 股权。

五、关联交易的定价情况

本次借款为上海新昇结合实际业务发展的需要向国盛集团提出的借款申请。本次借款的借款利率综合考虑了国盛集团的实际资金成本和公司的融资成本，定价公允、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、关联交易协议的主要内容

贷款方：上海国盛（集团）有限公司

借款方：上海新昇半导体科技有限公司

《借款合同》主要包括：

1、借款额度与用途：本次借款金额为人民币 10 亿元，需专款专用于集成电路用 300mm 硅片产能升级建设，不得挪为它用。

2、借款期限：本次借款期限为自贷款方向借款方放款借款之日起一年，或在一年期之前双方就国盛集团增资上海新昇签署增资协议并完成增资相关工商变更之日，或双方另行达成一致的日期止。

3、借款利息：自贷款方放款之日起，按用款日数计息。借款方应按季度向贷款方结息，结息日为每季末月的公历 20 日。

4、还款：借款方需按合同约定（或按双方约定的日期）一次性归还借款。借款期限届满后，贷款方有权将已发放的借款本金以债转股的形式转换为贷款方对借款方的增资，以取得相应的增资部分股权。

5、生效前提：（1）本次借款经有权国有资产监督管理部门备案批准；（2）本次借款经上海硅产业集团股份有限公司股东大会审议批准。

七、本次担保暨关联交易的必要性以及对上市公司的影响

本次向国盛集团借款专用于集成电路用 300mm 硅片产能升级，符合公司业务

发展和战略需求,将可进一步加快300mm半导体硅片的产能建设和技术能力提升,为进一步提升公司市场份额、巩固国内领先地位扩大优势,并对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响,符合公司的未来发展规划。公司为全资子公司提供担保,有利于提高公司整体融资效率,满足子公司项目建设资金的需求。被担保对象上海新昇为合并报表范围内的全资子公司,目前生产经营稳定,资产信用良好,无逾期担保事项,担保风险总体可控。本次借款并由公司为其提供担保暨关联交易事项不会对公司的经营产生不利影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

八、关联交易的审议程序

2025年8月12日,公司召开第二届董事会独立董事专门会议第五次会议,审议通过了《关于全资子公司向股东申请借款并由公司为其提供担保暨关联交易的议案》。经审议,全体独立董事认为:本次借款为上海新昇结合实际业务发展的需要向国盛集团提出的借款申请。本次借款的借款利率综合考虑了国盛集团的实际资金成本和公司的融资成本,定价公允、公平、合理,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。综上,全体独立董事同意全资子公司向股东申请借款并由公司为其提供担保暨关联交易的事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

2025年8月12日,公司召开第二届董事会第三十三次会议,审议了《关于全资子公司向股东申请借款并由公司为其提供担保暨关联交易的议案》,关联董事姜海涛、徐怡婷回避了相关事项的表决,相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,不考虑本次担保事项,公司对外担保总额为人民币902,103万元(其中:为全资子公司担保342,103万元,为控股子公司担保560,000万元),占上市公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别是73.35%和30.82%。

公司无逾期担保的情况。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 13 日